

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Batasan Masalah | 3 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Konsep Teori..... | 6 |
| 2.1.1 Definisi Kualitas | 6 |
| 2.1.2 Perspektif Kualitas..... | 6 |
| 2.1.3 Pengendalian Kualitas | 8 |
| 2.1.4 Six Sigma..... | 9 |
| 2.1.5 DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) | 12 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 25 |
| 3.2 Jenis Data dan Informasi | 25 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.4 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 26 |
| 3.4.1 Metode Pengolahan Data..... | 26 |
| 3.4.2 Analisis Data | 27 |
| 3.5 Langkah-langkah Penelitian..... | 29 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA..... | 30 |
| 4.1 Pengumpulan Data | 30 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan..... | 30 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan..... | 31 |
| 4.1.3 Produk di PT. Indonesia Toray Synthetics | 31 |
| 4.1.4 Alur Proses Produksi | 33 |
| 4.1.5 Data Produksi dan Target Produksi | 35 |
| 4.1.6 Data <i>Defect Chip E900</i> | 36 |
| 4.1.7 Data Total <i>Defect</i> Berdasarkan Jenis <i>Defect</i> | 36 |
| 4.2 Pengolahan Data | 36 |
| 4.2.1 <i>Define</i> (D) | 37 |
| 4.2.2 <i>Measure</i> (M) | 40 |
| 4.2.3 <i>Analyze</i> (A) | 44 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| 5.1 <i>Define</i> (D) | 52 |
| 5.2 <i>Measure</i> (M)..... | 54 |
| 5.3 <i>Analyze</i> (A)..... | 55 |
| 5.4 <i>Improve</i> (I) | 57 |
| 5.5 <i>Control</i> (C) | 58 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 60 |
| 6.1 Kesimpulan | 60 |
| 6.2 Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |